

证券代码：300656

证券简称：民德电子

深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-03

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：电话会议
参与单位名称	前海开源基金、银华基金、鹏华基金、长城基金、新华基金、创金合信基金、广东正圆基金、国海证券、华创证券、华福证券、国投证券、国信证券、长城证券、财通证券、东方财富证券、中泰证券
时间	2026年4月29日 15:00—17:00
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：陈国兵 证券事务代表：杨佳睿
投资者关系活动主要内容介绍	<p>首先介绍了民德电子2025年和2026年一季度主要财务数据情况，随后介绍了公司主要业务的发展情况，最后对投资者关心的问题进行了解答。</p> <p>一、公司财务情况介绍</p> <p>（一）2025年主要财务情况</p> <p>1、2025年，公司实现总营业收入30,315.92万元，较上年同期减少10,628.00万元，同比减少25.96%，主要原因系：（1）公司于2025年11月初将持有的控股子公司君安技术公司51%的股权全部转让，君安技术公司不再纳入公司合并报表范围，君安技术公司业务存在明显的季节性，四季度验收确认收入的金额较大，其2025年11-12月收入不再计入公司合并营业收入；（2）因2025年广芯微电子公司纳入公司合并财务报表范围，其与全资子公司民德（丽水）之间的设备租赁收入不再计入2025年合并营业收入。</p> <p>2、2025年，公司实现归属于上市公司股东的净利润-10,178.78万元，较上年同期增加1,212.80万元，同比增加10.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,418.80万元，较上年同期减少5,192.54万元，同比减少39.26%。主要原因系：（1）公司于2025年1月完成对广芯微电子的控股收购，根据会计准则核算，公司合并</p>

广芯微电子产生了部分投资收益，对公司非经常性损益有一定影响；（2）报告期内，公司对收购广芯微电子产生的商誉计提了 4,526.06 万元的减值准备；（3）报告期内，广芯微电子产能稳步提升，收入较上年同期大幅增长，但项目仍处于产能爬坡阶段，整体收入规模较小，而设备折旧摊销及人员等固定成本随着产能的提升较上年同期增加，导致广芯微电子仍处于亏损状态，且净利润同比减少；此外，2025 年 1 月后公司对广芯微电子持股比例的增加，也对归属于上市公司股东的净利润产生了一定影响。

（二）2026 年第一季度主要财务情况

1、2026 年第一季度，公司实现总营业收入 6,548.32 万元，较上年同期增加 1,150.42 万元，同比增长 21.31%，主要原因系：（1）晶圆代工厂广芯微电子纳入公司合并报表范围后，收入持续提升，报告期内收入 2,744.51 万元，较去年同期增长 243.64%；（2）功率半导体设计公司广微集成，报告期内收入 841.04 万元，较去年同期增长 193.38%；（3）公司于 2025 年 11 月转让持有的控股子公司君安技术公司全部股权，报告期内不再计入君安技术公司收入。

2、2026 年 1-3 月，公司实现归属上市公司股东的净利润-2,627.10 万元，较上年同期减少 5,974.20 万元，同比减少 178.49%；实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,757.18 万元，较上年同期减少 986.66 万元，同比减少 55.73%。主要原因系：（1）2025 年 1 月公司因合并广芯微电子产生的投资收益金额较大，导致本报告期归属上市公司股东的净利润同比减少较大；（2）广芯微电子虽产出及收入较上年同期有所增长，但因前期固定资产投入规模较大、折旧费用较高，且在产能爬坡期产出相对较小，单位固定成本较高，亏损金额同比有所扩大；（3）报告期内，AiDC 海外业务收入同比有所下滑，净利润同比下降。

二、公司业务发展情况介绍

（一）功率半导体业务进展

晶圆代工厂广芯微电子是公司构建长期护城河的核心战略资产，公司于 2025 年 1 月初完成对广芯微电子的控股收购，将这一最重要的资产纳入上市公司体系，并给予广芯微电子全力支持，助力其成为客户长期且值得信赖的功率器件和功率集成电路代工厂典范。同时，公司致力于构建的功率半导体 smart IDM 生态圈也在不断完善，核心环节企业产能快速提升，并不断强化各自之间的合作，通过产业协同，加快推动整体业务发展，实现特色工艺与供应链安全稳定。

1、晶圆代工厂广芯微电子

广芯微电子自设立以来，专注于特色功率半导体晶圆代工业务，聚焦高压、大功率半导体的研发与生产，在 6 英寸高端特色工艺晶圆代工产线的建设、运营及优化方面已取得了良好成果。2025 年，广芯微电子集中核心资源，重点完善工艺平台搭建，已完成包括 MOS 场效应二极管 (MFER)、垂直双扩散金属氧化物半导体场效应管 (VDMOS)、Bipolar-CMOS-DMOS (BCD)、瞬态电压抑制二极管 (TVS)、绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 的工艺平台搭建，产线产出自 2025 年初的 6,000 片/月提升至年底的 4 万片/月，产品良率持续保持高位稳定，客户数量稳步增长。广芯微电子也在根据客户需求不断开发新产品，面向智能电网应用的特高压 Smart MOS、高结温超高压 MFER 等产品线也都在陆续开发和推进量产中；同时，广芯微电子和广微集成、芯微泰克、晶睿电子等上下游伙伴的战略协同持续深化，产业链联动效应日益凸显。

广芯微电子目前整体产能规模仍相对较小，仍处于亏损状态；后续，广芯微电子将坚持稳健、高质量扩产，并持续推进新产品线和工艺平台开发工作，以更好服务优质客户需求。广芯微电子正通过提升产能、优化产品组合、优化工艺制程等措施，提升整体盈利能力，尽早实现经营净现金流转正和净利润转正。公司目前正通过多种渠道融资，用于晶圆代工厂的产能提升；2026 年 2 月，公司董事会已审议通过了向特定对象发行 A 股股票的预案，募集资金将主要用于广芯微电子的扩产及公司补充流动资金。

2、设计公司广微集成

功率半导体设计公司广微集成，6 英寸产品的产能已成功切换至新的晶圆代工厂，2025 年主要产品 MOS 场效应二极管 (MFER) 出货量持续快速提升，随着 MFER 产品销售逐渐恢复，广微集成的产品收入及毛利率也同比快速增长。除对已有产品进行不断迭代优化外，广微集成也在持续推进新产品工艺平台开发，包括超低压降势垒整流二极管、高压低导通压降二极管和快恢复二极管等都在进行工艺开发和产品验证。

(二) AiDC 业务进展

2025 年，公司 AiDC 业务在复杂的国际环境下保持相对稳健发展，产品性能不断提升，收入略有下降，维持了较好的毛利率水平，为公司持续贡献稳定经营性现金流。后续，公司将在更多行业细分领域探索机器视觉类新产品和市场，与细分市场龙头企业深度合作，推出更多具有极致性价比和差异化功能的新产品。AiDC 业务未来也将会长期作为公司“现金奶牛”业务，持续为公司提供资金和信用支持。

三、问答交流

1、功率半导体行业目前发展状态和趋势如何？

答：从去年四季度到今年，国内外多家功率半导体企业相继发布了涨价通知，一方面，受贵金属及部分电子化学品涨价等影响，半导体制造端成本有所增加；同时，受AI算力爆发式增长、电网电力设备升级等影响，功率半导体需求显著增加；再者，台积电、三星等国际国内大厂的产能调整，向利润更高、需求更旺的先进制程倾斜，收缩成熟制程产能，且不少之前在海外代工的企业出于供应链本地化考虑，也在寻求和大陆晶圆代工合作；多重因素的叠加，使得近期国内功率器件晶圆厂产能基本都处于满载状态，也为功率半导体行业带来了更大的市场机遇。

2、广芯微电子投建产线为6英寸，公司认为6英寸的优势和市场竞争力在哪里？

答：功率半导体行业普遍具有“小批量、多品种、定制化”的典型特征，特别是IGBT等高压、大功率产品，其应用导向性极强，与终端系统深度耦合，对定制化工艺调优及参数匹配的依赖性极高。相较于大尺寸晶圆产线，6英寸产线在应对多样化、快速迭代的产品需求时，具备天然的生产柔性及经济性优势，能够以更低的生产成本、更快的研发转化速度，响应客户在中高压、特种应用场景下的定制化需求。在性能与可靠性层面，6英寸晶圆因尺寸更小，在同等厚度条件下具备更优的结构强度与稳定性，由热膨胀系数失配引发的翘曲现象更为轻微；在高压、特高压IGBT等产品的背面减薄及金属化工艺中，6英寸晶圆的翘曲度可控制在更低水平，有效提升良率及产品长期运行可靠性。

在大功率供电系统、特高压电网、新能源储能变流器等应用场景中，对功率半导体的可靠性要求极为严苛，而由于结构差异，基于高端6英寸工艺平台的高压/特高压、大功率半导体往往能更好地满足上述需求，特别是在面向对功率半导体可靠性要求极为严苛的AI数据中心、新型能源革命等相关市场中，高端6英寸特色工艺平台及基于其设计的高压、大功率半导体产品具备更强的适配性，生产需求也显著攀升。

3、广芯微电子目前每月最大产出4万片，后续的产能释放节奏以及未来2-3年的发展规划？

答：广芯微电子目前每月最大产出4万片，公司目前也在通过多种渠道融资，推进广芯微电子的良性扩产。在定增募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，尽最大努力尽快实现10万片/月的产能目标。未来两年，广芯微电子核心任务是不断提升产能，并通过优化产品结构与精进工艺水平，全面

	<p>提升公司核心竞争力和市场影响力。</p> <p>4、公司对整个业务板块 2026 年的展望如何？</p> <p>答：（1）功率半导体业务：晶圆代工厂广芯微电子随着产能的提升，2026 年一季度收入较上年同期大幅增长，且合并范围外的设计公司客户销售额占比逐步提升；功率半导体设计公司广微集成 MFER 产品销售逐渐恢复，产品出货量持续提升，2026 年一季度收入同比增长 193.38%，公司功率半导体业务 2026 年营业收入预计同比有较大幅度增长。（2）AiDC 业务：自 2025 年下半年起，存储芯片价格持续上涨，AiDC 设备所需的芯片及金属原材料等成本亦显著攀升，使公司部分产品面临成本压力。公司通过积极引入新的供应商、优化产品结构、协同产业链上下游合作开发新产品等措施，积极应对供应链波动，以缓解其对经营的影响。公司 AiDC 业务未来仍保持相对稳健发展，维持较好的毛利率水平，为公司持续贡献稳定经营性现金流。</p> <p>5、公司 2026 年定增项目进展情况？</p> <p>答：2026 年 2 月 26 日，公司董事会审议通过了向特定对象发行 A 股股票的预案，拟向特定投资者发行 A 股股票募集资金总额不超过 10 亿元（含本数），用于“特色高压功率半导体器件及功率集成电路晶圆代工项目”和补充公司流动资金。公司计划以 2023 年至 2026 年一季度作为定增项目申报期，并将于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会审议定增预案，待股东会审议通过及申报文件齐备后将正式向深交所提交申请，经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册批复后方可实施。在获得深交所审核通过及中国证监会注册后，公司将向深交所和登记结算公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次发行全部批准程序。</p> <p>风险提示：本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026-04-29